

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

Disclaimer

본 자료는 주식회사 저스템(이하 “회사”)의 재정 상황, 운영·영업성과 및 회사 경영진의 계획·목표와 관련된 향후 전망을 포함하고 있습니다. 그러한 향후 전망은 회사의 실제 성과에 영향을 줄 수 있는 알려지지 않은 위험과 불확실성, 그리고 다른 요인들에 의해 변경될 수 있습니다.

회사는 본 자료에 포함된 정보의 정확성과 완벽성에 대해서 암묵적 또는 명시적으로 보장할 수 없으며, 본 자료에 서술된 내용은 과거 또는 미래에 대한 약속이나 진술로 간주될 수 없습니다.

따라서, 본 자료는 투자자들의 투자 결과에 대하여 어떠한 법적인 목적으로 사용되어서는 안되며, 회사는 본 자료에서 제공되는 정보에 의거하여 발생하는 투자 결과에 대해 어떠한 책임이나 손해 또는 피해를 지지 않음을 알려드립니다.

본 자료는 작성일 현재 시점의 정보에 기초하여 작성된 것이며, 회사는 향후 변경되는 새로운 정보나 미래의 사건에 대해 공개적으로 현행화 할 책임이 없습니다.

CREATIVE & INNOVATION
GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER

INVESTOR RELATIONS 2026

TABLE OF CONTENTS

Ch.01_ Company Overview

Ch.02_ Business Performance

Ch.03_ Business Overview

Appendix

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



01

Investor Relations 2026

Company Overview

01. Corporate Identity
02. 회사개요
03. 원천기술기반 성장스토리
04. 연구 개발 역량
05. 주요 생산 인프라
06. 기술 로드맵
07. 사업 영역



반도체 오염제어 솔루션 Global No.1 강소기업
IT & Energy 솔루션 Provider



업계 최고의 솔루션 보유

반도체 습도제어 솔루션 Global No.1

- 국내외 IDM업체 점유율 1위
- 세계최초 기류제어 시스템 개발(JFS)
- N2 LPM System 110여종 개발

업계 최고의 R&D 역량

- 특허 수 393건 확보
- 첨단산업 노하우를 보유한 연구진 보유
- 대한민국 최우수 기업 연구소 선정(K-HERO)
- 장영실상 수상

글로벌 Top-tier 고객사 확보

반도체



디스플레이 / 2차전지 / 태양광



독보적 기술 기반 성장동력 확보

핵심 공정 기술 기반
첨단 산업 모든 분야 대응 가능



회사개요

글로벌 첨단산업 수율개선 핵심 기업, 저스팀



회사개요

회사명	주식회사 저스팀
대표이사	임영진
업종	반도체, 디스플레이 부품 제조 및 생산
설립일	2016년 4월 25일
자본금	3,631백만 원
종업원	160명(2026년 3월 말 기준)
본사 및 공장	경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57 2공장: 경기도 화성시 동탄산단 10길 42
주요 고객	삼성전자, SK 하이닉스, 마이크론, 한화, LG 전자
영업 Agency	중국, 대만, 싱가포르, 일본, 미국

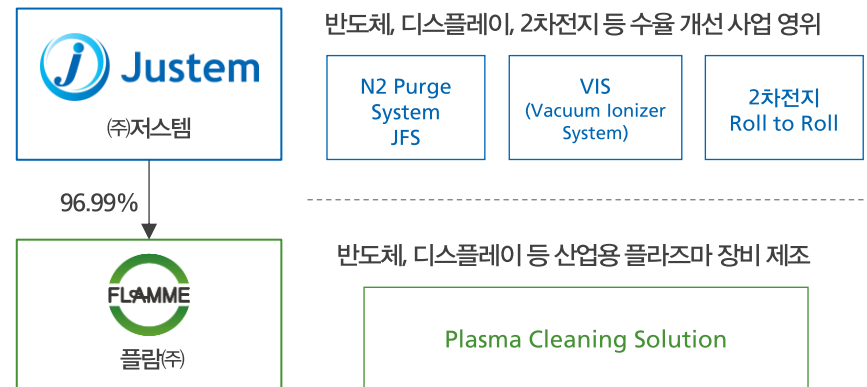
대표이사 소개



임영진 대표이사 (금속공학 박사)

- 2009. 지식경제부/한국산업기술진흥원 국무총리상 수상
- 2019. 무역의 날 대통령 표창수상
- 2020. 상공의 날 산업통상부 장관 표창수상
- 2024. 납세자의 날 중부지방국세청장표창수상

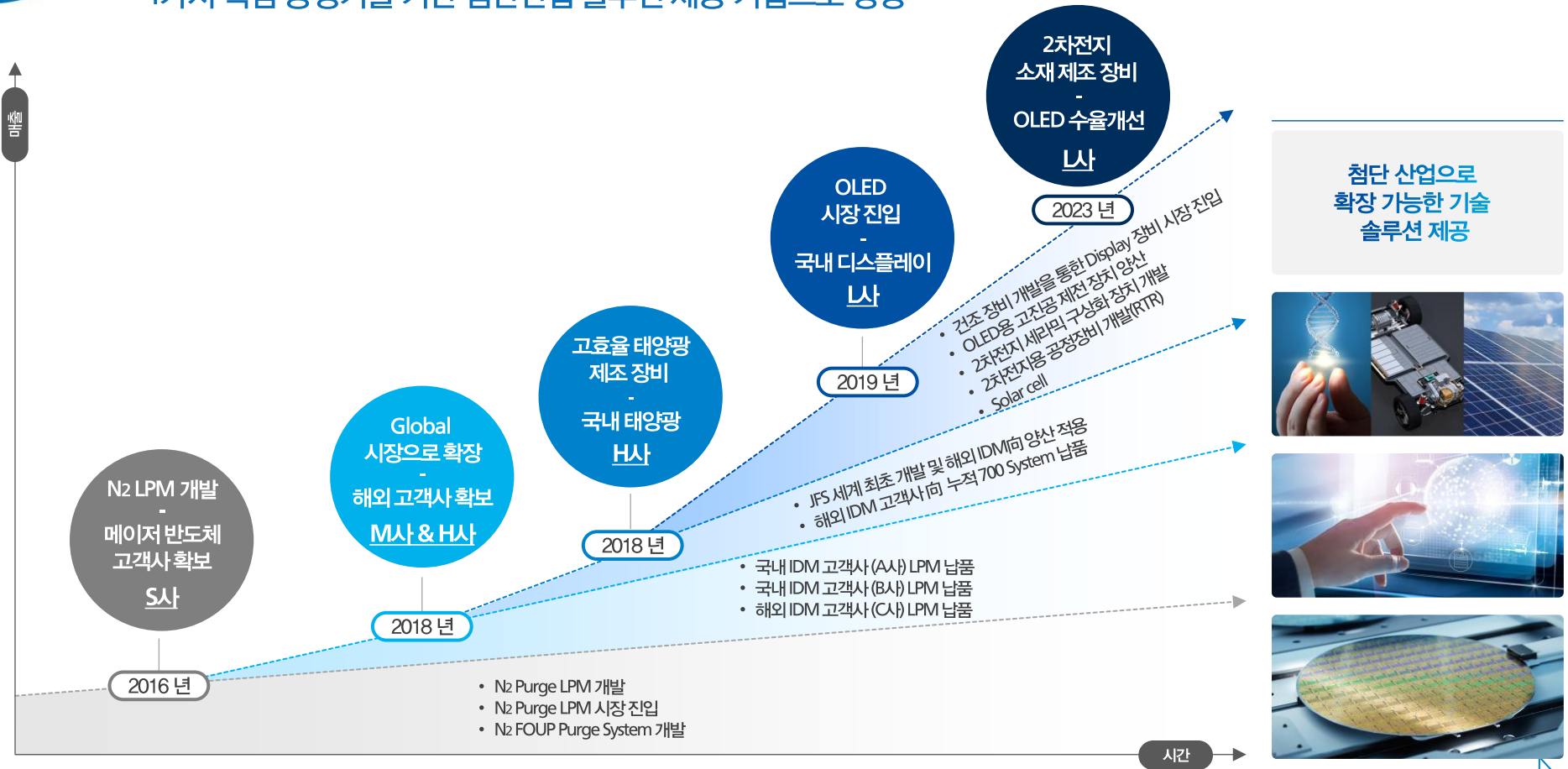
지배구조 및 사업영역



원천기술기반 성장스토리



4가지 핵심 공정기술 기반 첨단산업 솔루션 제공 기업으로 성장



4가지 핵심 공정

저스팀의 핵심 공정 융합 기술

N2 치환 및 기류제어를 통한 습도관리

진공 대응 기술

플라즈마, 열 응용기술

자동화 구성, Sequence 최적화 기술

첨단 산업 설계 기술

연구개발 역량

첨단산업 수율개선 글로벌 핵심 기업으로 성장하는 K-HERO 저스템



업계 최고 수준 R&D 경쟁력

최우수 기업연구소 선정



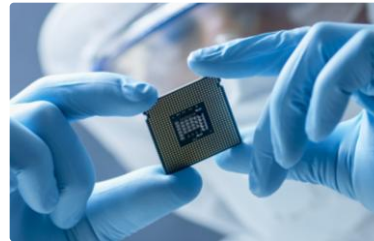
세계 최고 수준의 기업연구소로 성장할 잠재력을 가진 연구소 선정 (중소기업 유일 선별)

장영실상 수상



대한민국 정부가 인정하는 최고의 신기술 제품 혁신 상 (OLED용 고진공 이온화 제전장치)

첨단 기술 국책 과제 주관



반도체 첨단 패키징 선도기술 개발 국책과제 주관기업 선정 (HBM 하이브리드 본딩 장비)

세계일류상품 선정



산업통상부, KOTRA 주관 2025 세계일류상품 선정 (1세대 N2 로드포토모듈(LPM))

주요 인증 현황



특허 현황

기술 특허 확보, 진입장벽 구축



특허수 393건

등록수 154건

출원 239건

해외 41건

주요 생산 인프라



반도체 클러스터와 근거리에 위치한 첨단산업 제조 특화 생산 인프라 구축

저스렘 본사

위치 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 57
면적 4,012m²
생산 제품 반도체 N2 Purge System, JFS, JDM

2사옥

위치 경기도 화성시 동탄산단 10길 42
면적 5,544m²
생산 제품 2차전지 장비, 디스플레이 장비, 태양광 장비



반도체, 디스플레이 장비 제조 주력 사업장



반도체 생산 Fab

디스플레이 생산 Fab

디스플레이, 2차전지 장비 제조 주력 사업장



2차전지, 디스플레이 생산 Fab

플라즈마 장비 개발 Fab

기술연구소

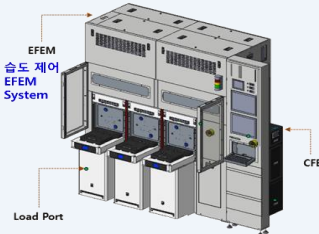
핵심기술(진공, 습도제어, S/W, 열, 대면적 기술) 확보를 통한 수평적, 수직적 제품 Portfolio 확대 가능



기술 경쟁력을 통해 반도체 / 디스플레이 / 태양광 / 2차전지 산업 내 다양한 사업 포트폴리오 구축

주요 사업 영역

반도체

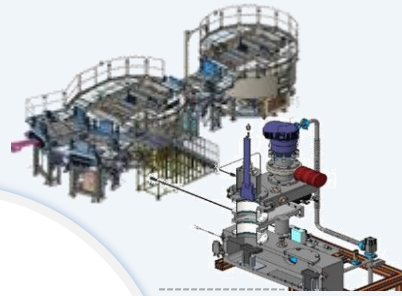


반도체 질소 순환(습도제어)솔루션

- N2 Purge System (LPM, BIP, CFB, STB)
- JFS U1, U5, AIP-JFS
- EFEM Dry Module
- HBM Hybrid Bonding 장비

SAMSUNG SK 하이닉스 micron HPSP

디스플레이



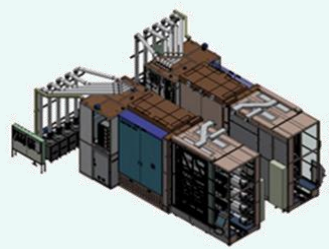
대면적 OLED 제조용 장비

- 10.5G OLED 用 HVCD 장비
- OLED용 진공 Transfer 장비
- OLED용 N2 Transfer 장비
- N2 Purifier (급속 치환 장치)
- Laser Patterning 장비
- Micro LED Repair

OLED 고진공 제전장치 VIS

SAMSUNG DISPLAY LG디스플레이 华星光电 CSOT Visionox

태양광



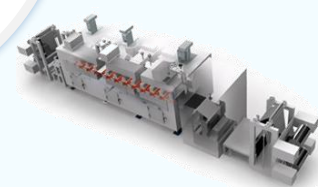
태양광 증착용 PECVD

- PECVD
- RPCVD
- POCL

Plasma cleaning

Hanwha First Solar

2차전지




2차전지 롤투롤 장비

- 전극 건조 장비

2차전지 열처리 장비

- 음극재 및 분리막용 세라믹 소성 소재
- 반도체 코팅 및 방열 소재

Japan Company(N社) LG전자



Justem

주요 제품 Line-up

**CREATIVE &
INNOVATION**

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



02

Investor Relations 2026

Business Performance

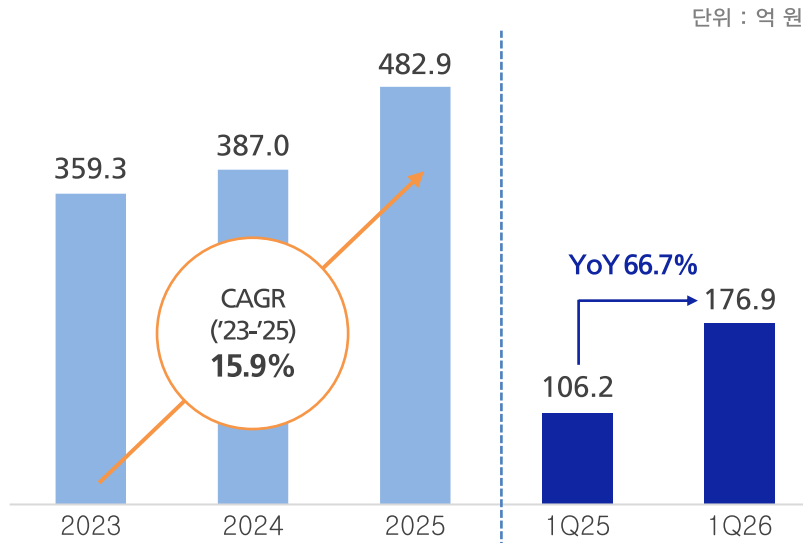
01. 경영성과 (1), (2), (3)

경영성과 (1)

반도체 주력 제품의 대규모 발주 기반 최대 규모 실적 및 수익 창출

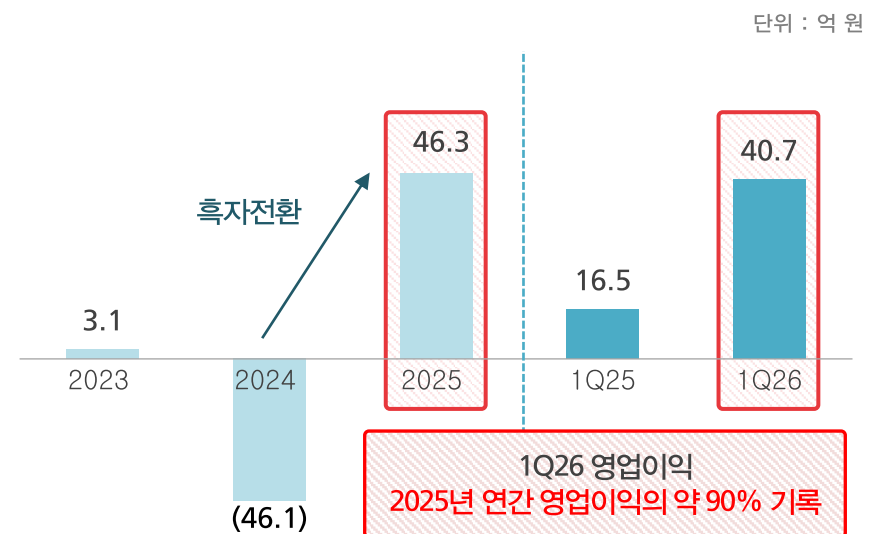
매출액 추이

창사 이래 역대 최대 분기 실적 달성



영업이익 추이

고부가 사업인 반도체 매출 비중 확대를 통한 이익 성장 가속화



경영성과 주요 요인

2026년 1분기 성과 주요 요인

- 글로벌 IDM 3사향 습도제어 솔루션 수주 확대에 따른 매출 성장
- 고부가 제품 중심의 매출 비중 확대로 제품 믹스 개선 및 전사 수익성 강화
- 습도제어 솔루션 수요 증가에 따른 글로벌 IDM향 수주 확대
 - S사 HBM 라인 및 미국 Fab, M사 글로벌 Fab, H사 HBM 라인 공급

향후 성장 요인

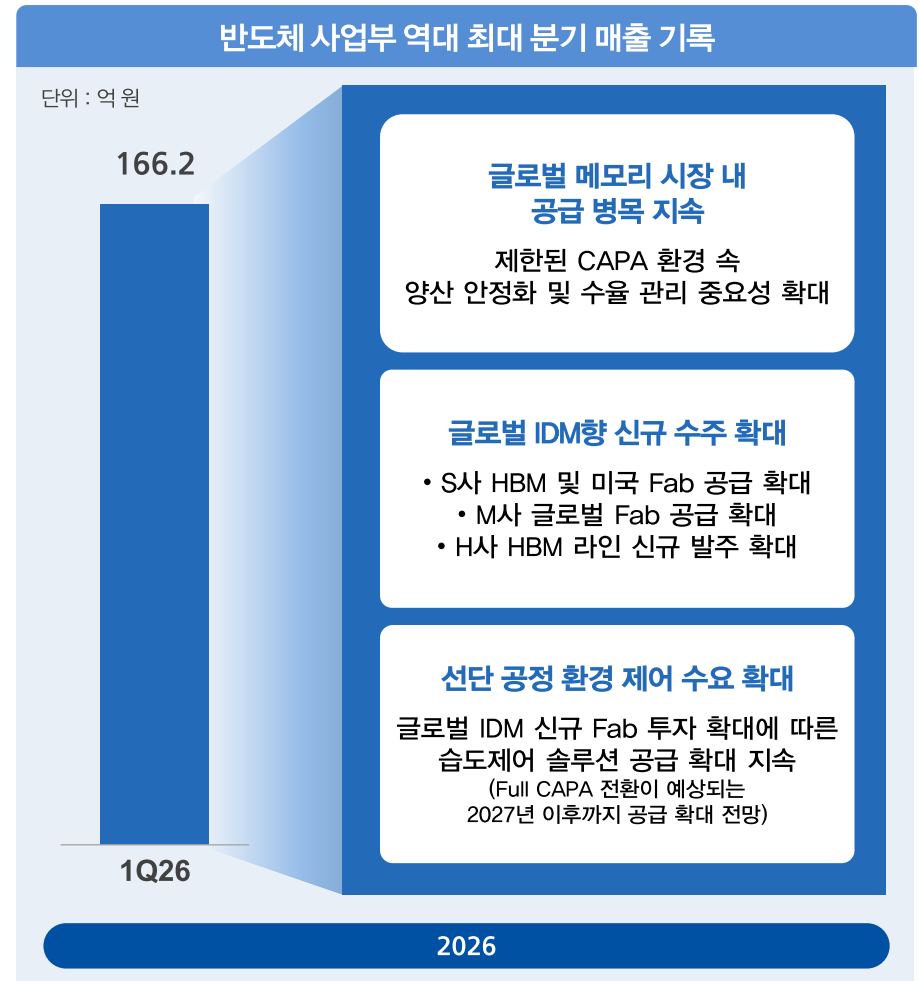
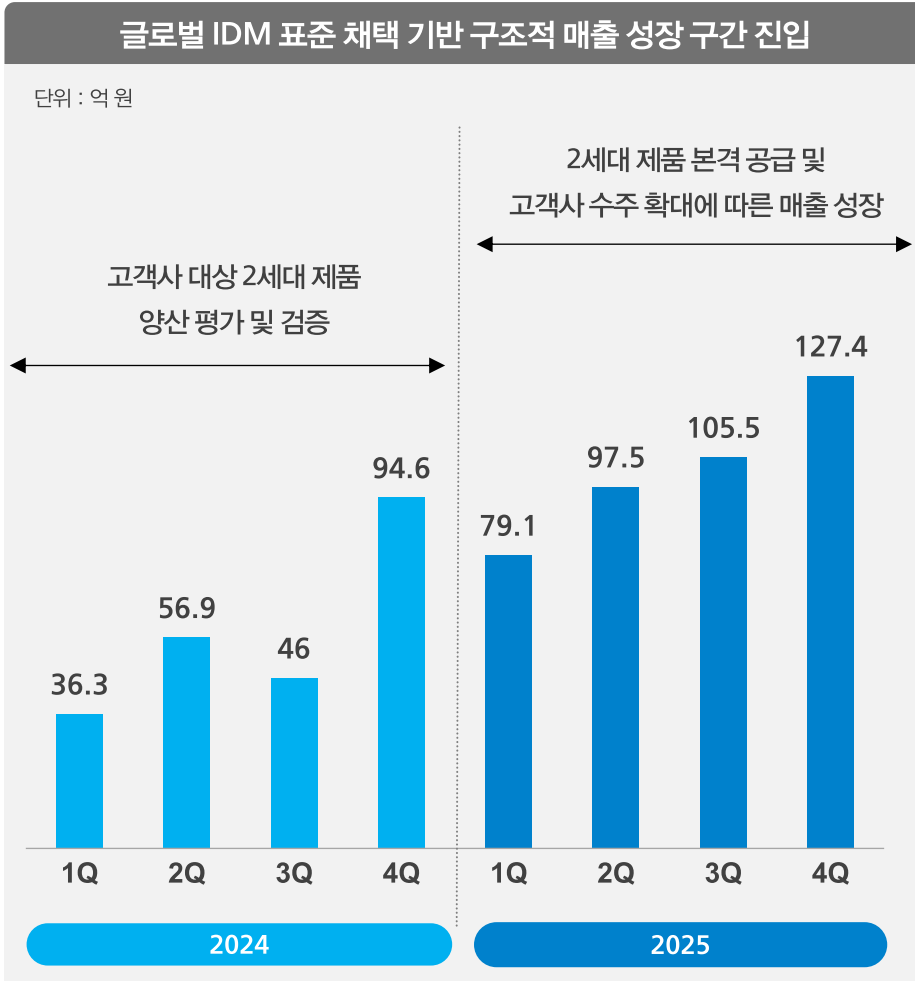
- 글로벌 IDM 3사의 CAPA 증설 및 선단공정 투자 확대에 따른 신규 라인 수주 기대
- 차세대 JDS 등 신규 장비 개발·출시를 통한 포트폴리오 확장
- 글로벌 파운드리 S사, U사 등과의 협업 기반 고객 접점 확대
- 공정 장비 레퍼런스 확보를 통한 OLED 제조라인 장비 수주 가능성 제고

주1: 2022 ~ 2026년 1분기는 외부 감사인의 검토가 완료된 연결 K-IFRS 기준

주2: 2021년 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은, 2020년은 감사를 받지 않은 K-IFRS 개별기준

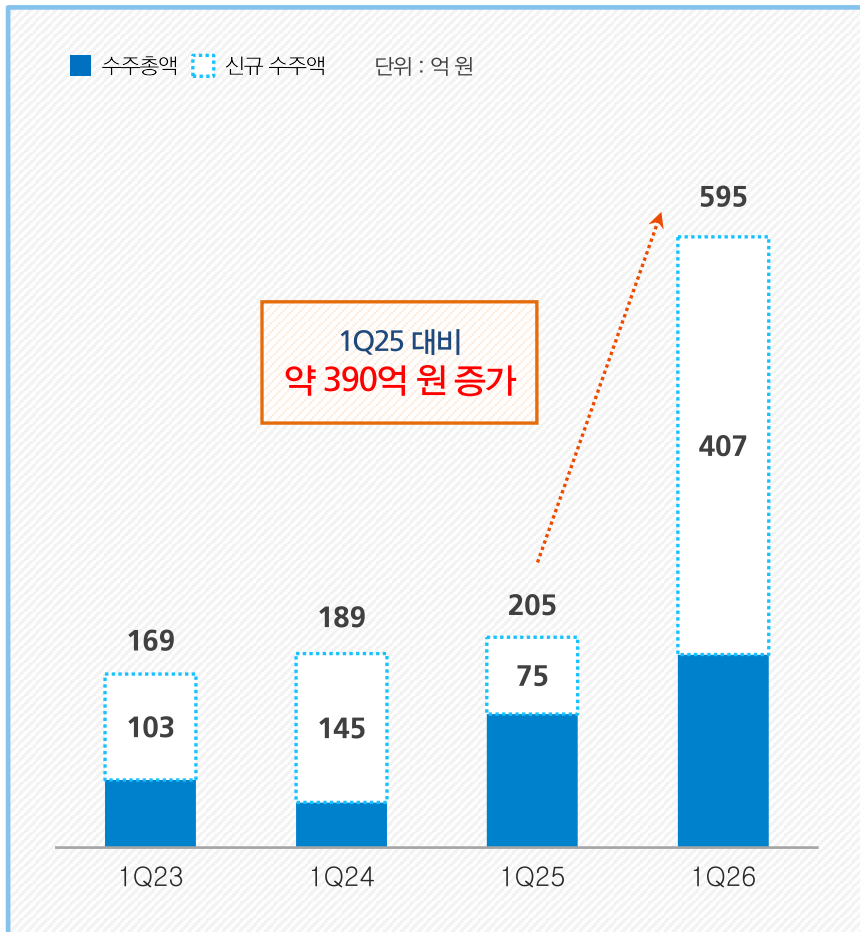
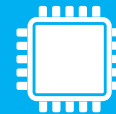
주3: 2016 - 2019년 재무제표는 K-GAAP 개별기준

반도체 사업부 매출액 추이



주: 2024 ~ 2026년 1분기는 연결재무제표 기준

수주현황 및 잔고 (2026년 1분기 기준)

반도체
부문

- 미국 테일러 Fab향 N2 Purge System 공급 추진
- H사 HBM 라인향 신규 Fab 공급 확정
- M사 미국·대만·일본 신규 법인향 대규모 발주 확보
- 2026년 차세대 습도제어 솔루션 JDS 상용화 목표로 제품 고도화 진행
- 제품 포트폴리오 확장을 위한 신규 장비 개발 진행
- 글로벌 파운드리 기업 S사 및 U사와 협업을 통한 고객 접점 확대

디스플레이
부문

- 공정 장비 레퍼런스 확보 및 중장기 성장 모멘텀 유지
- L사향 OLED 제조라인 대규모 장비 수주
- OLED 대형화에 따른 신규 고집적 장비의 정전기 제어 수요 대응 장비 개발 완료

03

Investor Relations 2026

Business Overview (1) 반도체

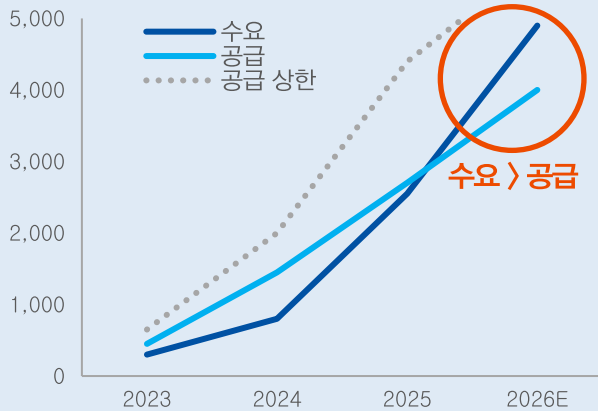
01. 반도체 시장 환경
02. 글로벌 IDM 고객 현황 및 확장 계획
03. 글로벌 IDM Capex 현황
04. 반도체 공정 내 습도 제어의 중요성
05. 반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어, 저스팀 (1), (2)
06. 습도 제어 솔루션 제품 포트폴리오
07. 반도체 수율 개선 시스템 고도화 (1), (2), (3)
08. 저스팀의 습도 제어 솔루션

반도체 시장 환경

공정 미세화와 차세대 전환에 따른 수율 안정화 수요 확대



HBM 비트 수요 및 공급 현황



자료: Trendforce

생산 CAPA 확대 속도 제한 속
핵심 공정 병목 현상

IDM 3사의 핵심 과제는 수율 확보

SAMSUNG

- HBM4용 1c D램 수율 목표를 기존 60%에서 **85%로 상향 조정**
- D램 수율 1%p 개선 시 수천만 원 규모 추가 이익 발생

SK 하이닉스

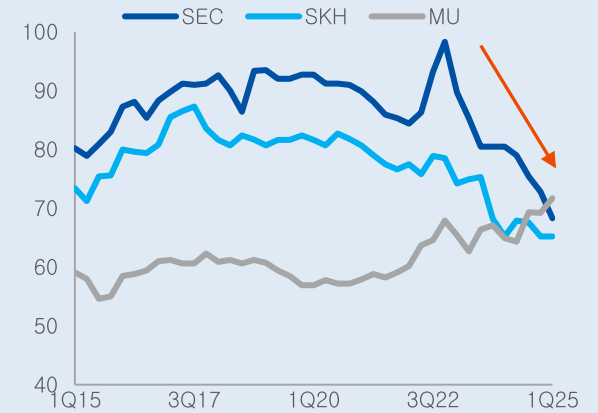
- 올해 양산 예정인 HBM4에서 **이전 세대 수준의 수율 확보 목표**
- 생산 극대화에도 고객 수요 전량 충족이 어려운 상황

micron

- D램 재고일수 120일 미만의 타이트한 수급으로 **공급 제약 지속 전망**
- 주요 고객 수요의 약 50% 수준만 충족 중이며 CAPEX 상향 진행

자료: 각 사 보도자료

글로벌 IDM 3사 유효 수율 추정치



자료: Trendforce

차세대 공정으로의 전환 과정 속
수율 확보 난이도 상승

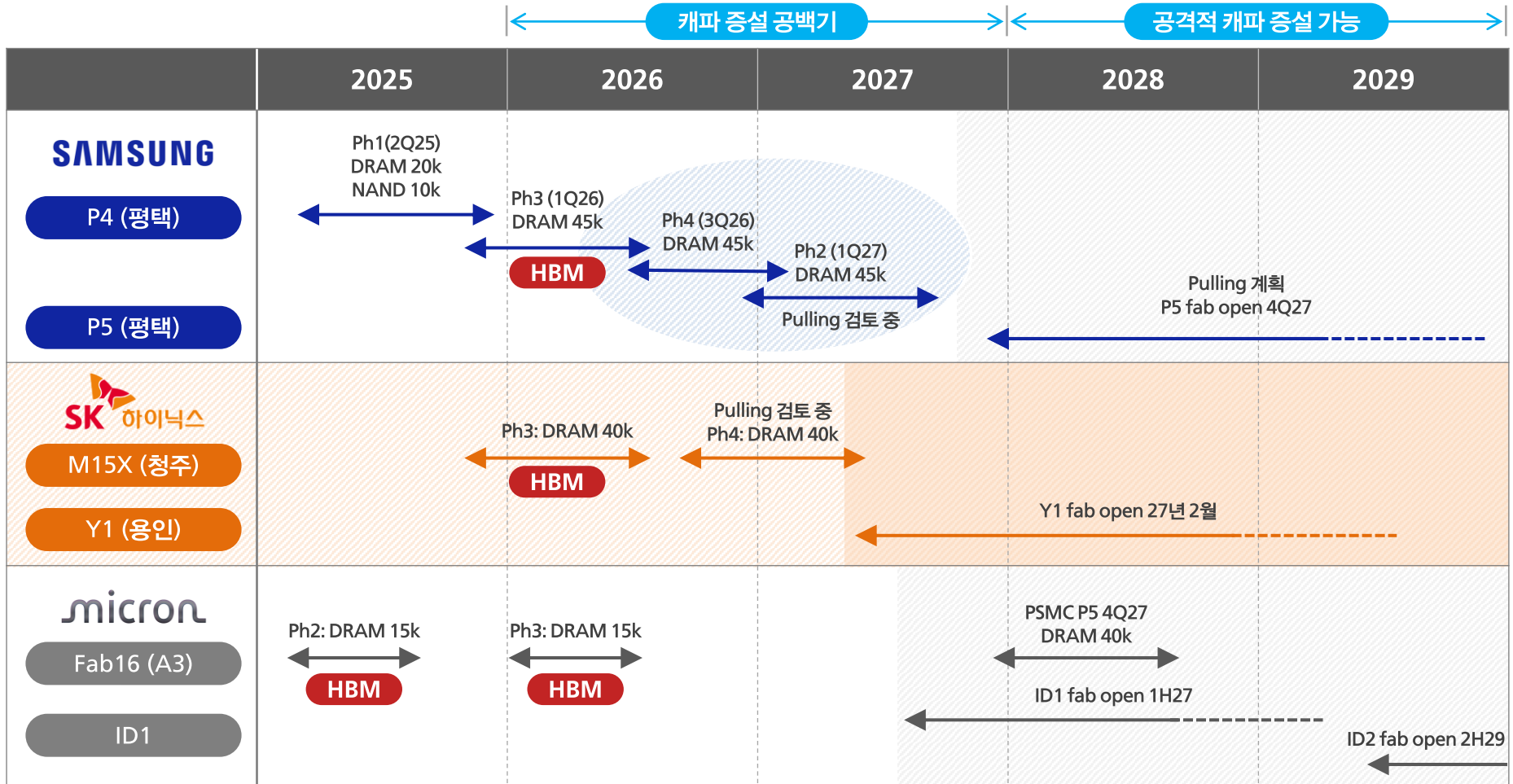
주요 IDM 사들은 생산성 극대화를 위해 공정 내 수율 개선 장비 채택 확대

글로벌 IDM Capex 현황

글로벌 IDM 메모리 운용은 2027년 하반기까지 공급 병목 예상



글로벌 IDM Capex 운용 전망



자료: 삼성증권 추정

반도체 공정 내 습도 제어의 중요성

반도체 전공정 전반에서 수율에 직접적인 영향을 미치는 습도 제어에 대한 중요성 증가

반도체 전공정 미세화에 따른
기존 Clean Class 1 환경의 한계 도달

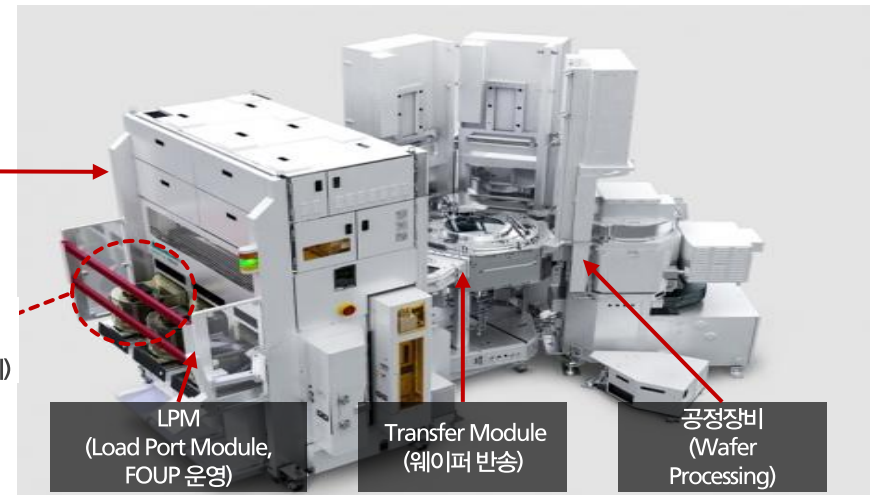
공정간 오염 물질 및 수분 발생으로
생산 수율 감소 문제 발생

반도체 전공정 습도관리 솔루션
중요성 부각

반도체 공정 Fab. : FOUP을 통해 공정간 웨이퍼 이송



반도체 공정 장비 : 웨이퍼 이송 → 오염원이 없는 청정 상태 유지 필수



웨이퍼를 외부 오염 및 습도로부터 보호 및 보관하는 용기
공정간 이송 시 사용되어 수율에 직접적인 영향



반도체 Clean Class 1 한계 도달

Class 1
(0.5 μ m 이상,
≤ 1ea/ft³)

습도
40%~50%

온도
23~25°C

기존 LPM 습도 제어의 한계 발생

기존 LPM

기존 LPM 습도 : 45%

- 공정 미세화에 따른 기존 LPM의 45% 습도 유지 한계 발생
- 반도체 수율에 악영향을 미치는 고습도 환경 조성



미세화된 공정 내 습도로 인한 소자 손실 발생

Cu Corrosion(Loss)

Defect/Particle Growth

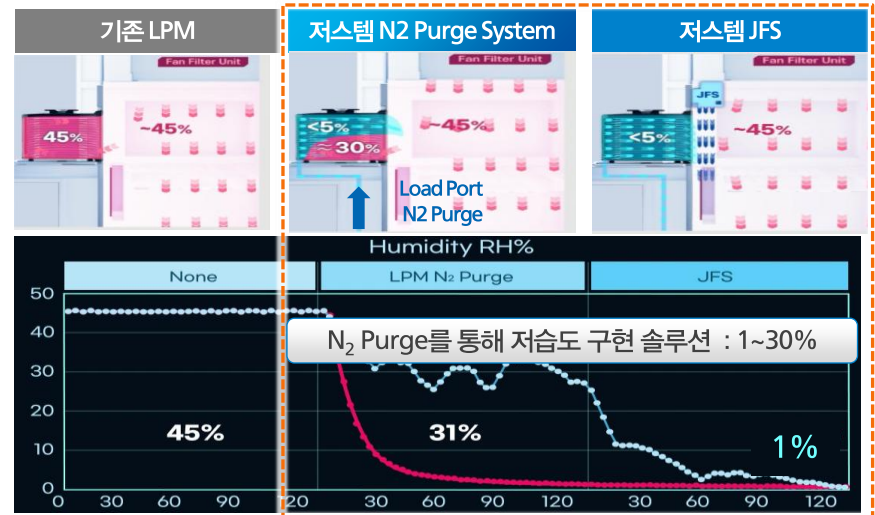
수율 개선 관련 기술적 한계 봉착

저스팀 저습도 관리 솔루션

N2 Purge System란?

반도체 웨이퍼 이송 및 보관을 위한 LPM에 핵심 기술인 노즐을 장착 및 개조 후 N2(질소)를 주입하여 웨이퍼 습도 제어 및 불순물 제거하는 시스템

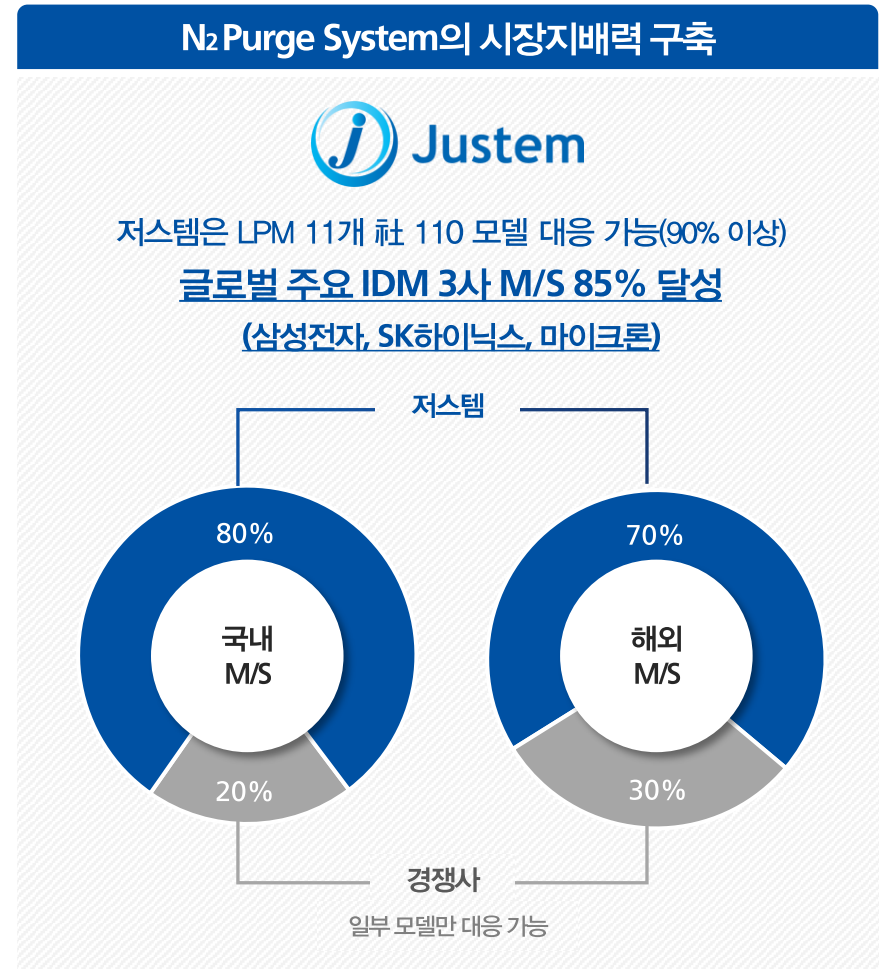
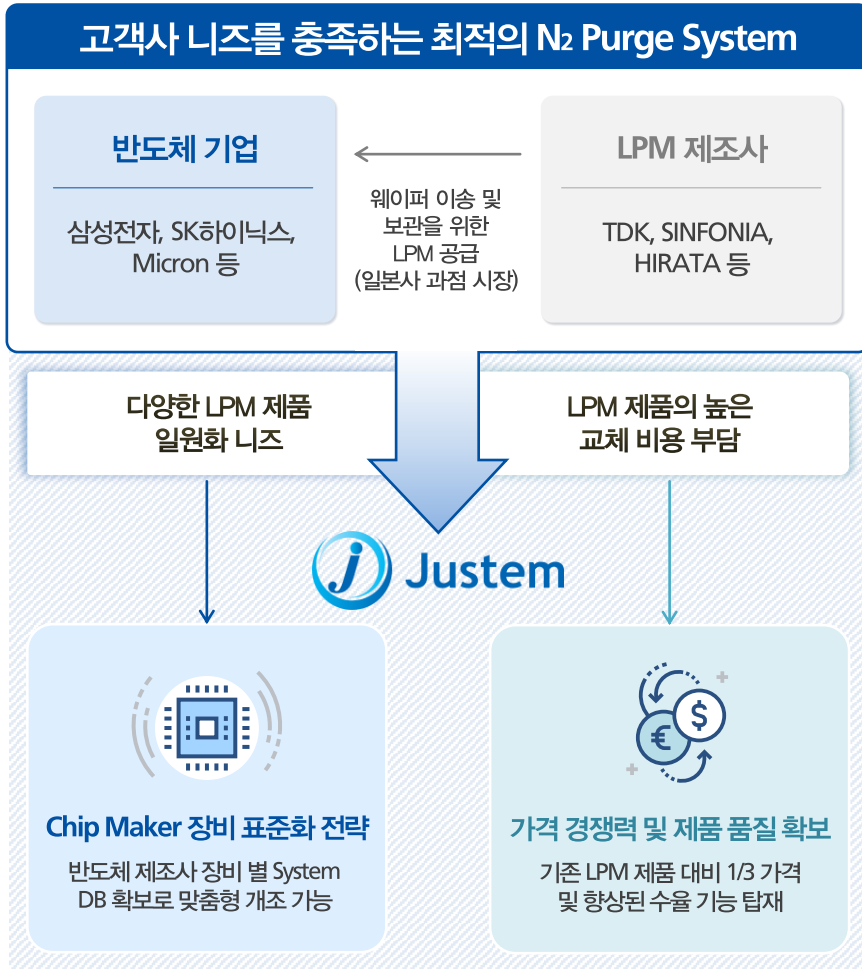
FOUF 내부 환경 제어를 통해 웨이퍼 품질 및 신뢰성 상승



수율 제어를 통한 초미세화 공정 수율 증대
IDM 3사 표준화 적용
(Fab 당 1,500억 원 절감 효과)

반도체 시장 내 수율 개선 핵심 플레이어, 저스팀 (2)

효율적인 수율 개선을 위한 최적의 선택지 N2 Purge System



*2025년 시장점유율 기준

습도 제어 솔루션 제품 포트폴리오

다양한 고객 수요에 대응 가능한 제품 Line-up 구축

N2 Purge System 제품 소개

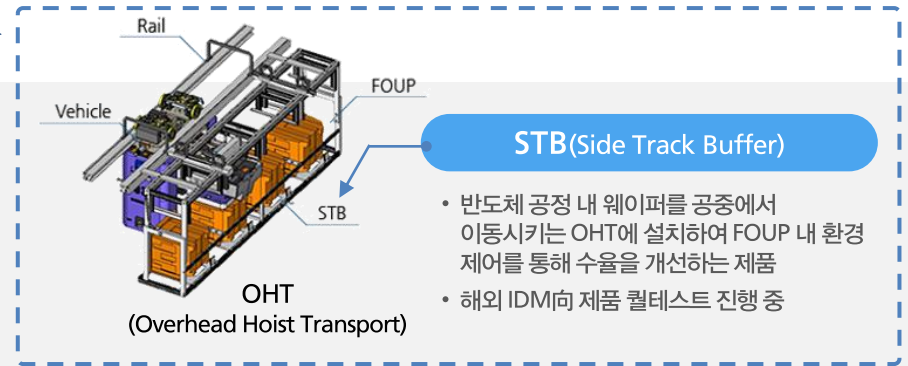
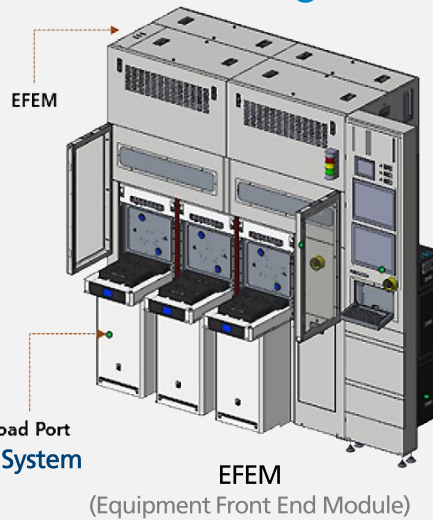
N2 Purge LPM

- 반도체 공정 내 매엽식 장비에 장착되는 LPM(Load Port Module)*에 부착 및 개조되어 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품

BIP(Built In Purge)

- Batch 타입 반도체 증착 장비에 N2를 Purge 할 수 있는 모듈을 장착 및 개조하여 수율을 향상시키는 제품

Load Port
LPM N2 purge System



STB(Side Track Buffer)

- 반도체 공정 내 웨이퍼를 공중에서 이동시키는 OHT에 설치하여 FOUP 내 환경 제어를 통해 수율을 개선하는 제품
- 해외 IDM 向 제품 쉐 테스트 진행 중

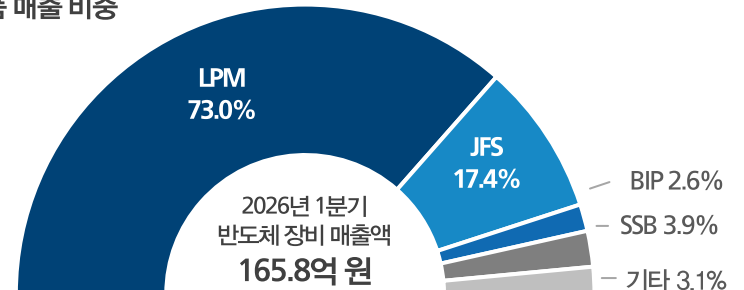
CFB(Contamination Free Buffer)

- EFEM 좌, 우측에 설치되어 공정이 진행되어 오는 웨이퍼에 N2를 Purge 하여 수율을 향상시키는 제품
- 장비 제조사에 공급 추진 중

주요 고객사

N2 Purge LPM	SAMSUNG	SK 하이닉스	micron
CFB	SEMES		
BIP	SK 하이닉스	micron	HPSP

주요 제품 매출 비중



반도체 수율 개선 시스템 고도화 (1)



지속적인 제품 고도화 → 반도체 산업 내 수율 개선 부품/장비 핵심 기업으로 성장 기대

저스템 1세대 N2 Purge System : JLPX

[반도체 Fab 공정간 웨이퍼 이송 장비]



LPM N₂ Purge System

질소를 활용한 기류제어 방식으로 습도 제어 및 웨이퍼 불순물 제거

*2025년 기말 기준 누적매출 2,601억 원 (수출 1,066억 원)

저스템 2세대 JFS

JFS (Jet Flow Straightener, Zone 습도저감모듈)

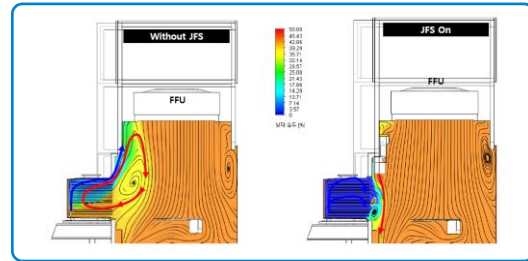
Fan Filter

JFS

~45%

<1%

세계 최초 기류 제어를 통한 습도관리 시스템



JFS : EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 상시 저습도로 제어 가능

미국 M사 向 1,500 System 이상 판매
국내 장비업체와 성능평가 진행 중

기존 1세대 이상의 매출 기대

저스템 3세대 JDM

JDM (Justem EFEM Dry Module for 1%, Space 습도저감모듈)

EFEM 내부 전체 습도 제어 가능한 비순환형 제습 모듈
EFEM 내부 습도 < 5%, FOUP 내부 습도 < 1%
소비전력 최소화, 온도제어 가능

기대효과

- 선제적 제품고도화로 시장 기술 선도
- +
- 국내 EFEM 제품 비중 확대로 국산화 기여
- +
- 반도체 산업 내 시장 점유율 확대

국내 장비업체와 성능평가 진행 중

반도체 수율 개선 시스템 고도화 (2) JFS



세계 최초 JFS 개발을 통해 글로벌 IDM사의 HBM/DRAM 공정 내 핵심 솔루션으로 표준 채택

세계 최초 기류 제어 습도제어 솔루션

JFS
(Jet Flow Straightener)

EFEM으로부터 유입되는 고습도 기류 차단으로 폼(FOUP) 내 습도를 상시 1%이하로 제어 가능

~45% 습도 감소

<1% 습도

저습환경 제공으로 수율 개선 효과 검증

반도체 분야 수율 제어 표준기술 채택 기대

반도체 첨단 투자 집중 전략 수혜

국내 및 해외 IDM사 向 JFS 공급

공정평가 후 단기간 내 S사, M사 주요 Fab으로 공급

- 2024.03 M사 일본 Fab 공급 (112port)
- 2024.03 M사 대만 Fab 공급 (175port)
- 2025.03 M사 싱가포르 Fab 공급 (101port)
- 2025.11 S사 평택 Fab 공급 (50port)
- 2026.01 S사 평택 Fab 공급 (310port)

고객사 요청 기반 평가 기간 단축 및 양산 전환 가속

글로벌 IDM 제품 상용화 계획

글로벌 Top3 IDM 업체 현장 평가

A사	B사
<ul style="list-style-type: none"> • 평가완료 및 공급 진행 	<ul style="list-style-type: none"> • 평가진행 중
<ul style="list-style-type: none"> • JFS 360 System 공급 완료 • 메모리 및 파운드리 선단 공정 向 추가 수주 기대 	<ul style="list-style-type: none"> • 25년 평가 완료 목표 • 메모리 선단 공정 向 수주 기대

다양한 IDM 고객사 확보에 따른 시장 선점 기대

반도체 수율 개선 시스템 고도화 (3) JDS



차세대 통합 환경 제어 솔루션 JDS 개발을 통해 EFEM 환경 제어 패러다임 전환 선도

반도체 공정 Unmet Needs

소자 고집적화로 공정 환경 민감도 증가

→ 습도 및 공정 잔류물(Fume/Particle)로 인한 수율 저하

초미세 공정 진입에 따른 환경 제어 한계

→ 기존 단일 제어 방식으로 대응 어려움



공정 환경에 최적화된
통합 환경 제어 솔루션 구현

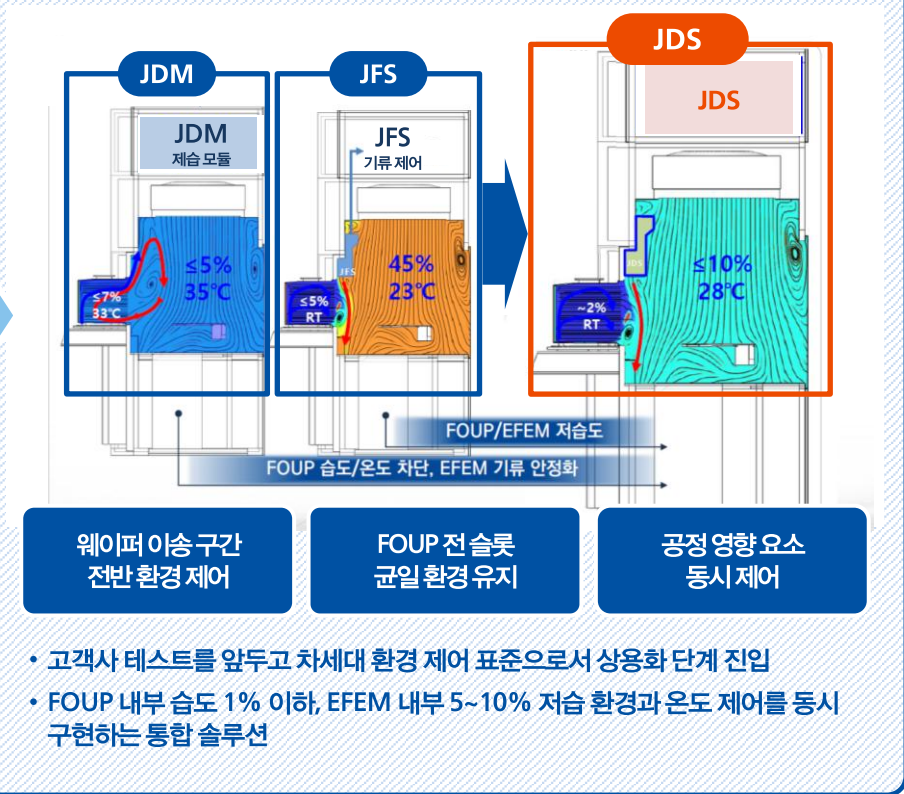
고정밀 제습 기술 (JDM)
(FOUP/EFEM 저습 환경 구현)



기류 균일 제어 기술 (JFS)
(전 슬롯 균일 기류 확보)

저스팀 솔루션

JDS (Justem Dry System) = JDM(제습) + JFS(기류 제어) 통합 솔루션
EFEM(Equipment Front End Module) 습도·온도·분자오염(AMC) 제어 통합 관리



저스템의 습도제어 솔루션

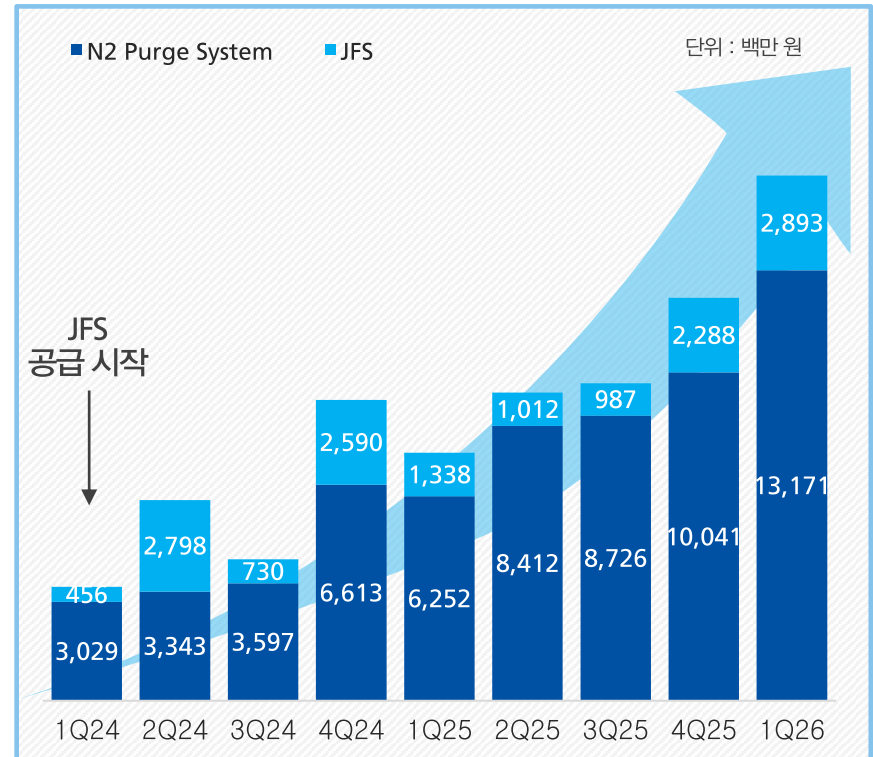
1세대·2세대 솔루션의 시너지를 통해 초저습 공정·수출 혁신 실현



글로벌 주요 IDM 3사향 저스템 공급 FAB 현황

저스템 습도제어 솔루션	
1세대: N ₂ Purge System	2세대: JFS
FOUP, Transfer Module 등 웨이퍼 이동·보관 위치	EFEM 입구 및 공정 챔버 위치
외부 환경의 습기 차단 / 오염 방어막 역할	내부 공정의 정밀 제어 / 균일한 습도 유지
<p>외부 차단과 내부 제어의 완벽한 시너지로 초저습 공정·수출 혁신 실현</p>	

습도제어 솔루션(1, 2세대) 매출 추이



1세대·2세대 제품의 동반 공급 확대에 따른 습도제어 솔루션 매출 성장 가속화

CREATIVE &
INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



04

Investor Relations 2026

Business Overview

(2) 신규 사업

01. 디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축
02. 태양광 산업 진출 본격화 (1), (2)
03. 자회사와의 시너지 창출

디스플레이 시장 내 수율 극대화 라인업 구축

OLED 시장의 수율개선 필요성 증대로 공정 및 설계기술 기반 시장진출



디스플레이 산업 동향

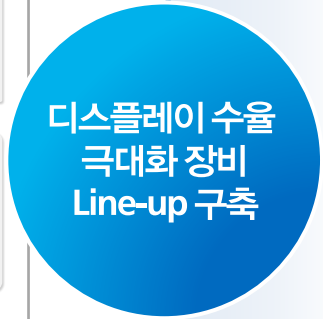
6G → 8.6G ITOLED 대형화로 신규 투자 기대

: 2stack tandem Cell등 차량 및 IT 기기향
OLED 수요 증가로 신규 투자 발생

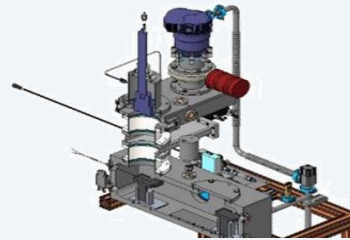
OLED 패널 불량관리/수율 향상 중요성 증가

: 수율 개선을 위해 각 공정 이동 간 진공
환경에서의 패널 이송 장비 필수 요구

글로벌 디스플레이 패널 기업들의
OLED 패널 수율 향상 니즈 증가



OLED 증착공정 수율 극대화 솔루션



대면적 OLED 제조용 고진공 장비

고진공 환경내 OLED의 소자불량을 유발하는 정전기 제거를 위한 제전장치로 OLED 패널 수율 향상을 위한 필수 기술

M-VIS(중진공 제전장치) 개발을 통한 사업영역 확대

※ 장영실 상 수상

대면적 고진공
제전 균일도 확보

고객사에서
양산 검증 완료

반도체 분야 수율 제어
기술 레퍼런스 보유

국내 업체 제품 상용화 계획

주요 디스플레이 업체 현장 평가

A사

- 양산평가 진행 중
- 중진공영역대 추가평가 진행 중

• '26년 고진공영역, 중진공 영역
양산적용 예정

B사

- 중진공 양산평가 진행 중
- 전위센서, 이온센서 적용 중

• '26년 순차 적용 예정

해외 업체 제품 상용화 계획

주요 디스플레이 업체 현장 평가 진행 중



중화권 지역 타깃 고객사

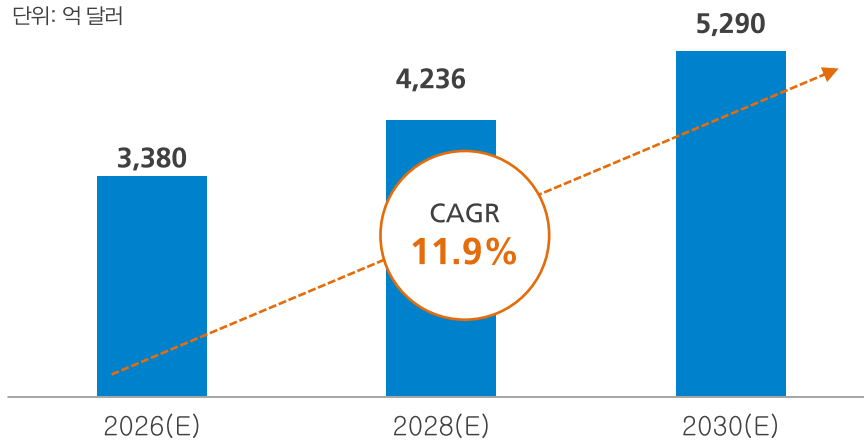


태양광 산업 진출 본격화(1)

차세대 태양광 기술 변화에 따른 저스팀의 수혜 확대

글로벌 태양광 시장 전망

단위: 억 달러



- 글로벌 빅테크의 전력망 병목 심화로 자체 전력 확보 필요성이 확대되며, 태양광 설치 수요 증가
- 글로벌 빅테크 중심 우주 태양광 구축 본격화, 차세대 에너지 인프라 경쟁 가속



AI·우주 인프라 확대로 전력 수요가 구조적으로 확대되며,
안정적 전력 확보를 위한 신규 전력원 수요 증가

자료: Researchandmarkets, ENERGIUM

국내 주요 태양광 기업 미국 진출 현황

태양광 시장 확대에 따른 국내 주요 태양광 기업 미국 진출 확대
→ 미국 내 태양광 통합 생산단지 '솔라 허브' 구축

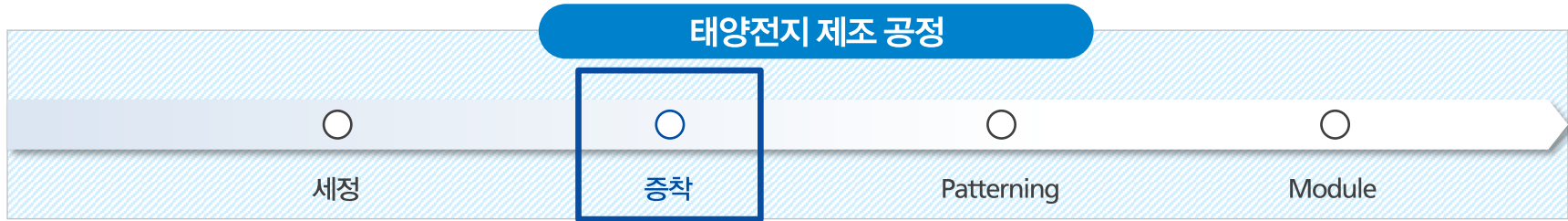


북미 최초 태양광 수직 계열화 밸류체인 완성
국내 소부장 기업과 협업 기대

자료: 언론 보도자료

태양광 산업 진출 본격화(2)

신규 기술 기반 태양광 산업으로 매출확대 본격화



태양광 사업 전략 방안

국내 고객사 국내외 site (한국, 미국, 중국 등) 설비투자 적극 대응
→ 국내 고객사 대형 웨이퍼 생산 라인에 PECVD, MOCVD 수주 예정

+

국내 태양광 기업과 우호적인 파트너십을 통한 거래선 적극 활용
(국내 태양광 기업 向 누적 매출 177억 원 돌파)

자회사와의 시너지 창출



독자적인 플라즈마 기술을 적용한 Cleaning Solution으로 사업 포트폴리오 다각화

기업 개요

1. 회사명: 플람주
2. 설립일: 2016년 11월
3. 자본금: 26백만 원(2024.3월 기준)
4. 주요 사업 분야: 반도체, 디스플레이 등 산업용 플라즈마 장비
5. 특허: 플라즈마 관련 특허 31건



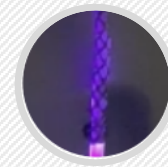
플라즈마 기술 포트폴리오



Multi Plasma



Cold Plasma
(독자 기술)



Surface Plasma



DCSBD Plasma

M&A를 통한 사업 포트폴리오 확장 시너지 창출

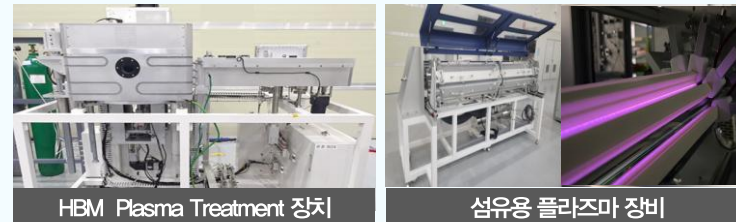
디스플레이



- OLED소재변화로 저온 플라즈마 기술 적용필요 (플람 -60° C/타사-200° C) 기술 우수
- LGD Cold Plasma 기술 기반 OLED 소재 세정 장비 도입 (남경, 베트남)



반도체 / 섬유



- HBM Plasma Treatment 장치
- 섬유용 플라즈마 장비
- 300mm Wafer to wafer Hybrid bonding용 Plasma treatment 장치
- 섬유 연속 In-Line 플라즈마 표면처리 장비 (정련, 표백공정/ 염색 공정의 탄소배출량 감소)

정부지원 국책과제

— Thank you —

주주와 함께 성장하는
저시스템이 되겠습니다.



Q&A

The image shows a perspective view of a server room with rows of white server racks. The racks are filled with various electronic components and cables. The ceiling is high and features a complex network of white metal beams, yellow cables, and air conditioning units. The floor is a light-colored, polished surface. The entire scene is overlaid with a dark blue background and numerous out-of-focus light blue circles of varying sizes, creating a bokeh effect. The text 'Q&A' is centered in the middle of the image in a white, bold, sans-serif font.

CREATIVE & INNOVATION

GLOBAL NO.1 HIGH-TECH SOLUTION PROVIDER



Investor Relations 2026

Appendix

01. 요약 재무제표

재무상태표

단위 : 백만 원

구분	1Q24	1Q25	1Q26
유동자산	26,509	26,157	36,291
비유동자산	55,801	54,304	62,300
자산총계	82,311	80,461	98,591
유동부채	14,427	29,129	32,341
비유동부채	22,381	1,334	2,080
부채총계	36,808	30,463	34,421
자본금	3,625	3,625	11,332
자본잉여금	21,032	21,222	20,824
기타자본	1,403	2,496	3,030
이익잉여금	19,459	22,696	29,037
비지배지분	-16	-40	-52
자본총계	45,503	49,998	64,170

주: KIFRS 연결 재무제표 기준

손익계산서

단위 : 백만 원

구분	1Q24	1Q25	1Q26
매출액	4,064	10,617	17,693
매출원가	2,886	4,874	-8,661
매출총이익	1,178	5,743	9,031
판매비	5,314	4,096	-4,959
영업이익	-4,136	1,646	4,073
금융손익	-27	-117	746
기타손익	50	8	10
법인세비용차감전순이익	-4,113	1,538	4,605
법인세비용	0	0	0
당기순이익	-4,113	1,538	4,605

주: KIFRS 연결 재무제표 기준